

Fiche d'application 40

Dépôt de nickel pour la soudure de SC

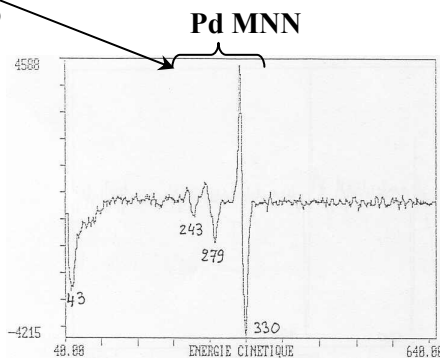
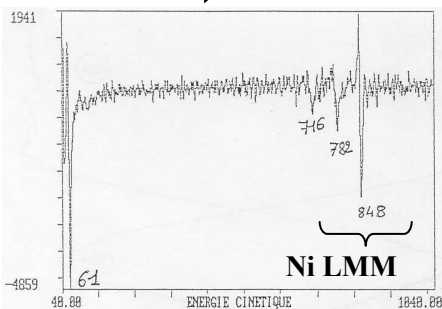
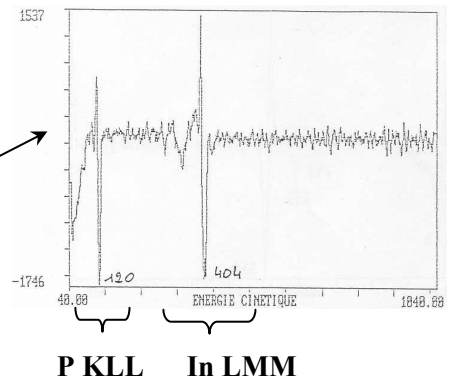
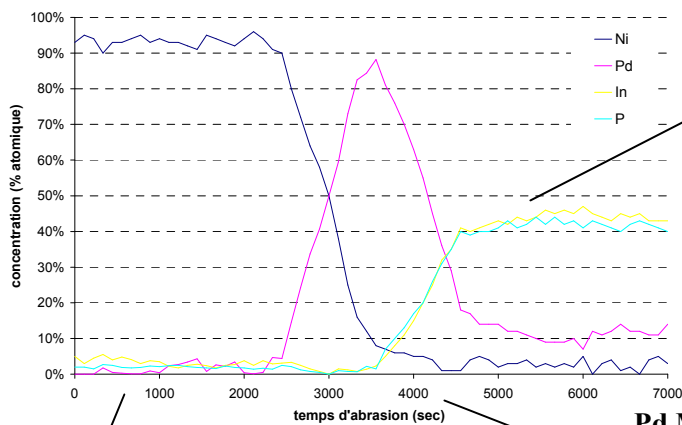
V2

Objet : Dépôt d'une couche barrière de palladium dans le but d'éviter la diffusion de nickel dans un matériau InP et obtenir une bonne soudabilité

Technique mise en œuvre : AES

- ✓ Epaisseur de la couche barrière ➔ quelques 10 nm
- ✓ Analyse élémentaire et quantitative sur quelques 10 μm²
- ✓ Profil de répartition en profondeur sur qq 100 nm

Résultats :



Conclusion :

Visualisation des couches de Pd et de Ni en surface de l'InP. Pas de diffusion aux interfaces